



2021年5月19日

各 位

会 社 名 株式会社RS Technologies  
代表者名 代表取締役社長 方 永義  
コード番号 3445 東証第一部  
問合せ先 取締役管理本部長 鈴木 正行  
電 話 03-5709-7685

## (開示事項の経過) 当社海外子会社の上場準備に伴う、同子会社による 第三者割当増資、及び当社持分法適用会社の株式譲渡に関するお知らせ

当社は、2020年9月11日付け「当社海外子会社の上場準備に関するお知らせ」にて開示致しました、有研半導体材料有限公司（以下「GRITEK」）の科创板市場（スター・マーケット）での上場に向けた準備の一環として、2021年5月19日開催の取締役会において、GRITEKによる機関投資家及び当社への第三者割当増資の実施、並びに、当社持分法適用会社である山東有研 RS 半導体材料有限公司（以下「SGRS」）の全株式を GRITEK へ譲渡することを決議したので、お知らせ致します。

### 1. 第三者割当増資について

#### ① 概要及び実施目的

GRITEK は、今年6月を目途として、機関投資家及び当社へ第三者割当増資を実施致します。機関投資家への第三者割当増資では、科创板市場（スター・マーケット）上場後の株主多様性の確保、また、当社への第三者割当増資では、当社による GRITEK 支配力の強化を目的としております。GRITEK は引き続き当社の重要な連結子会社であることを前提としております。本件後の各社保有比率等につきましては、以下の資料をご参照下さい。なお、保有比率等は現時点のデータに基づくものであり、今後変動する可能性があります。

#### ② 日程

(1) 取締役会決議日	2021年5月19日
(2) 契約締結日	2021年5月中を予定
(3) 第三者割当増資実行日	2021年6月中を予定

### 2. 持分法適用会社の株式譲渡について

#### ① 概要及び実施目的

現在、当社は持分法適用会社である SGRS 株式の 19.99%を保有しています。本譲渡では、当社が保有する SGRS 株式全てを、GRITEK へ株式交換により譲渡致します。

本譲渡を通じて、SGRS の持分法適用会社としての位置づけは変わりませんが、SGRS の株式は、GRITEK を通じて間接保有することとなります。当社では、今後、中国でのプライムウェーハ事業展開にあたり、8インチプライムウェーハ事業を手掛ける GRITEK を通じて、12インチプラ

イムウェーハ事業を手掛けていくことが、プライムウェーハ事業における戦略実現に資すると判断し、本譲渡を実施することと致しました。本件後の各社保有比率等につきましては、以下の資料をご参照下さい。なお、保有比率等は現時点のデータに基づくものであり、今後変動する可能性があります。

## ② 持分法適用会社の概要

(1) 名 称	山東有研 RS 半導体材料有限公司 (SGRS)
(2) 所 在 地	中国山東省徳州市
(3) 代表者の役職・氏名	方永義 (董事長、当社代表取締役社長兼務)
(4) 事 業 内 容	12 インチシリコンウェーハ及び CZ インゴット・FZ インゴットの生産、販売、開発、関連技術の開発、12 インチシリコンウェーハの再生、その他。
(5) 登 録 資 本 ※	20 億元 (約 340 億円)
(6) 設 立 年 月 日	2020 年 3 月 11 日
(7) 大株主及び持株比率	当社 : 19.99%、有研科技集团有限公司 (GRINM) : 19.99%、徳州滙達半導体股權投資基金パートナー企業 : 60.02%

※最終的な資本構成であり、契約スケジュールに沿い、段階的な出資を予定。

## ③ 株式譲渡の相手先の概要

(1) 名 称	有研半導体材料有限公司 (GRITEK)
(2) 所 在 地	中国北京市
(3) 代表者の役職・氏名	張果虎
(4) 事 業 内 容	シリコンウェーハ及び CZ インゴット・FZ インゴットの新産、販売、開発、関連技術の開発等
(5) 資 本 金	971 百万元 (約 165 億円、2020 年 12 月 31 日現在)
(6) 設 立 年 月 日	2001 年 6 月 21 日
(7) 大株主及び持株比率	北京有研 RS 半導体科技有限公司 (BGRS) : 42.75%、GRINM : 25.60%、当社 : 23.51%、社員持株会 : 5.00%、福建倉元投資有限公司 : 3.14%

## ④ 日程

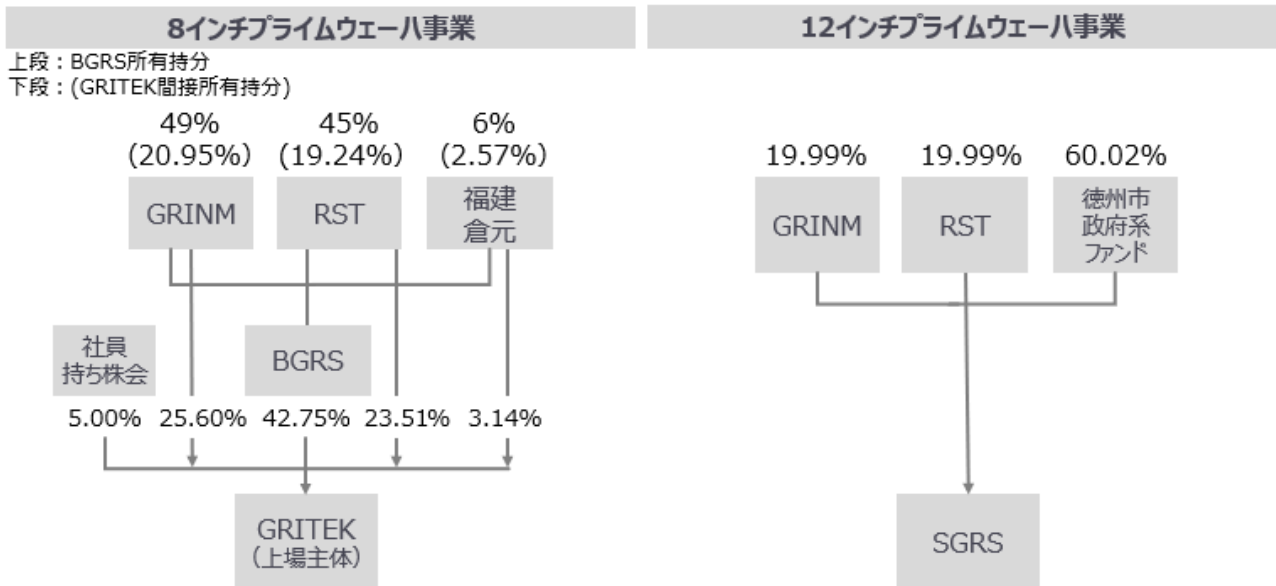
(1) 取 締 役 会 決 議 日	2021 年 5 月 19 日
(2) 契 約 締 結 日	2021 年 5 月中を予定
(3) 株 式 譲 渡 実 行 日	2021 年 6 月中を予定

## 3. 今後の見通し

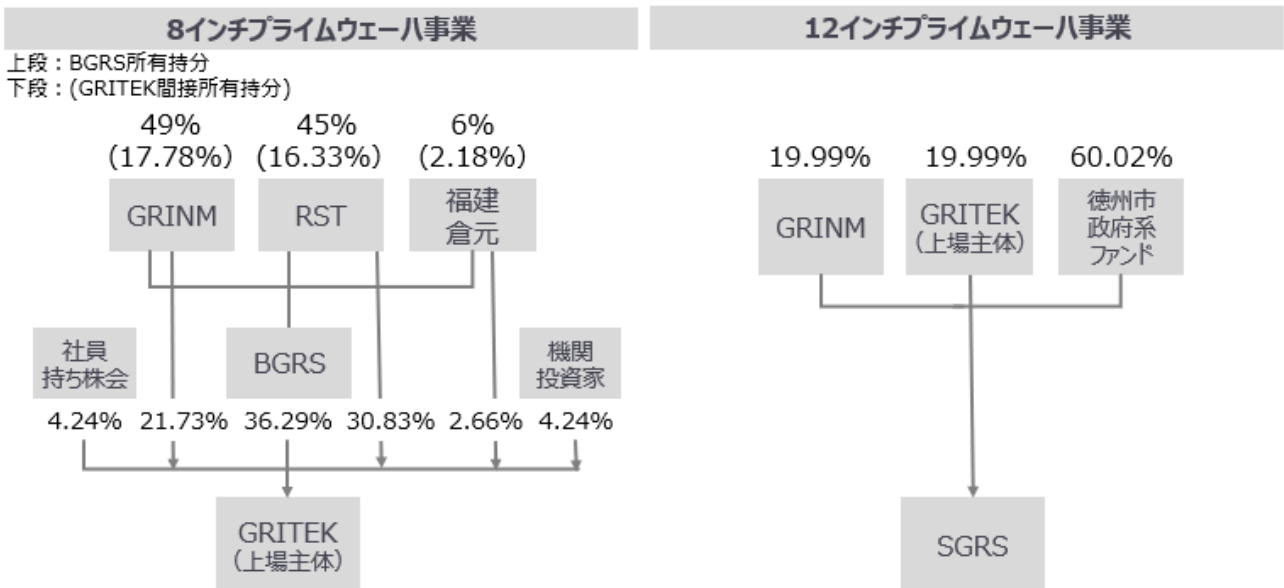
本件が、当期の当社連結業績に与える影響は軽微であると考えておりますが、今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかに開示致します。

(資料) 資本構成スキーム図

(1) 本件前



(2) 本件後



以上

この文書は、当社連結子会社である有研半導体材料有限公司の科创板市場（スター・マーケット）への株式上場へ向けた準備に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではなく、またこの文書又はその一部は、中国、日本、米国その他の地域において関連する契約、約束又は投資判断の基礎を成すべき又は依拠されるものではありません。したがって、この文書は、米国を含むいかなる法域においても、株式又は有価証券の募集又は取得勧誘を構成し又は意図するものではありません。米国においては、登録又は登録免除なしに有価証券の募集販売はできません。公募を通じた有価証券の購入は、当該有価証券に関する最終のオフERING・メモランダム又はプロスペクタスに含まれる情報のみを基礎として行われるべきです。現時点において、当社は米国において有価証券の公募を行う意図を有していません。